

Press Release

JIG-SAW



ROHM GROUP
LAPIS
SEMICONDUCTOR

2016年7月28日

JIG-SAW 株式会社

ラピスセミコンダクタ株式会社

JIG-SAW、LSI・半導体・モジュール接続する産業機器向け IoT データコントロールサービスに参入

- Mobicomm、ラピスセミコンダクタと技術提携・共同開発契約 -

JIG-SAW グループ(JIG-SAW 株式会社、以下 JIG-SAW 及び Mobicomm 株式会社、以下 Mobicomm) は、ロームグループのラピスセミコンダクタ株式会社(以下ラピスセミコンダクタ)と技術提携及び共同開発契約を実施し、JIG-SAW グループの IoT データコントロールサービスと無線通信 LSI 及び無線通信モジュールとを連動させ、ICS(Industrial Control Systems) 分野において新しいサービスを展開してまいります。

近年、産業システム分野においては、ICS がインターネット(IoT:Internet of Things)の一部としてネットワーク化され、産業機器の稼働データ、各種センサーデータなど、膨大な数の端末データを容易に取り込み、セキュリティを高めた通信が求められています。JIG-SAW グループではこれらの課題を解決する IoT Module 組込み技術及び A&A(Auto Sensor-ing & Auto Direction)サービスを保有し、通信モジュール・センシングなどの IoT デバイスを提供してまいりました。

そして、この度、様々な通信で接続される産業機器の稼働状況の自動モニタリング、データ収集・解析とともにデータ、ソフトウェアの自動アップデートを可能とするセキュアな環境を提供する新しい IoT データコントロールサービスを確立し、インダストリーインターネットサービス分野へ進出してまいります。

この産業機器向け IoT データコントロールサービスは、ラピスセミコンダクタの無線通信 LSI 及び無線通信モジュールと接続されるものであり、今後、あらゆる分野の産業機器に、稼働データ収集・解析、稼働監視などに利用される通信システムにラピスセミコンダクタが提供する無線通信 LSI、BLE/Bluetooth SMART、特定小電力無線(Sub-GHz、Wi-SUN)、ZigBee(IEEE802.15.4)に対応した無線通信モジュールを接続してまいります。これらのサービスと連動する組込み用アプリケーションを Mobicomm とラピスセミコンダクタが共同でモジュールへ組込むことにより、JIG-SAW の IoT データコントロールサービスを容易に

利用できる IoT デバイスプラットフォームをご提供してまいります。

なお、Mobicomm はラピスセミコンダクタと無線通信分野において、従来から技術協力関係にあり、双方の技術の蓄積をベースにより新しい取組みを実現してまいりました。ラピスセミコンダクタの超低消費電力 RF を搭載した Bluetooth SMART 対応通信 LSI を採用した Beacon、通信 Module、Gateway の開発、Sub-GHz 帯無線通信 LSI を採用した通信 Module、などの製品化を行っており、引き続きさまざまな規格に対応した LSI を搭載した通信モジュールの開発、製品化を推進してまいります。また、Mobicomm は通信モジュール開発及び組込み技術には定評があり、無線通信技術、モジュールの開発に必要な技術、シールドルームや測定器などの設備を保有するとともに多数の「キャリアグレード」の通信モジュール開発や機器への組込みに実績があります。

■ Mobicomm の通信モジュール、機器組込み実績

- ・スマートフォン組込み最小 PHS Type-G Module
- ・クレジットカード型端末組込み PHS+Bluetooth Module
- ・車載用組込み 3G Module (海外ベンダーと協業)
- ・M.2 Type Cat4 LTE Module (4Band 対応)
- ・スマートフォン組込み Cat4 LTE Module (2Band 対応)
- ・BLE SMART 低消費電力モジュール
- ・Sub-GHz Module 他

JIG-SAW

■ JIG-SAW 株式会社

会社名：JIS-SAW 株式会社（東京証券取引所マザーズ：証券コード 3914）

所在地：東京本社／東京都千代田区大手町 1-9-2 18F

札幌本店／北海道札幌市北区北 8 条西 3 丁目 32

代表者：代表取締役 山川真考

設立年月日：2001 年 11 月 1 日

業務内容：JIG-SAW 株式会社は人工知能制御による IoT データコントロール及びロボット型ソフトウェアモジュール群による全自動 IoT プラットフォーム及び分散型 E2E データコントロールアーキテクチャー(分散レジャー)及び MEC(Mobile Edge Computing)基盤提供、次世代リアルタイム OS・最先端各種チップモジュール群及び通信制御技術の研究開発等を軸に、ビジネスシステムの最適制御・運用技術「オペレーションテクノロジー(OT)」をベースにした全産業の自動化・分散化・シェアリング化を加速させる次世代の A&A ロボットテクノロジーカンパニー。OS 技術及びグループ会社の Mobicomm 社による組み込み技術及び専用ソフトウェアのバランスチューニングによる分散型エッジ超並列高速処理技術、超高速通信技術、ゼロ消費電力通信技術及び色・信号制御

技術を保有。



■ Mobicomm 株式会社

会社名：Mobicomm 株式会社（Mobicomm Inc.）

事業所：本社 / 東京都千代田区大手町 1 丁目 9 番 2 号 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 18F
東北ラボ / 岩手県花巻市二枚橋第 5 地割 6 番地 38 H 棟

代表者：代表取締役 田中芳邦

設立年月日：2012 年 4 月 5 日

事業内容：通信制御・データ信号制御をはじめとした基礎技術をベースにしたモバイル通信機器、ソフトウェア・モジュール開発・組込みあらゆる分野・領域へ組込み可能な革新的な超軽量ソフトウェア・モジュール・センサー・アルゴリズムの研究開発

ROHM GROUP



■ ラピスセミコンダクタ株式会社

会社名：ラピスセミコンダクタ株式会社

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜 2-4-8

設立年月日：2008 年 10 月 1 日

代表者：代表取締役社長 岡田 憲明

事業内容：ロジック LSI、メモリ LSI、表示用ドライバ LSI の開発・製造・販売、ファンダリビジネス

本件に関する問い合わせ先

JIG-SAW 株式会社 経営管理ユニット 広報担当 TEL：03-6635-6657

ラピスセミコンダクタ株式会社 ニュースリリース担当 TEL：045-476-9212